

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. ⁶ C08L 83/07	(11) 공개번호 특 1996-0010783	(43) 공개일자 1996년 04월 20일
(21) 출원번호	특 1995-0034045	
(22) 출원일자	1995년 09월 30일	
(30) 우선권주장	94-261953 1994년 09월 30일 일본(JP)	
(71) 출원인	다우 코닝 도레이 실리콘 캄파니, 리미티드 다나베 에이이치 일본국 도쿄도 추오쿠 니혼바시무로마치 2초메 3반 16고	
(72) 발명자	아다치 히로시 일본국 치바켄 이시하라시 치구사카이간 2반 2 사루야마 도시오 일본국 치바켄 이시하라시 치구사카이간 2반 2	
(74) 대리인	이병호, 최달용	

심사청구 : 없음

(54) 원 패키지 실은 경화성 실리콘 엘라스토머 조성물

요약

본 발명은 경화되기 전에는 작업성이 우수하며 경화되는 동안에는 외력에 의해 변형되는 경우에 조차도 균열되거나 분열되지 않는 특성을 갖는 황변되지 않은 원 패키지 RTV 실리콘 엘라스토머 조성물에 관한 것이다. 이들 원 패키지 실은 경화성 실리콘 엘라스토머 조성물은 말단 그룹의 50몰% 이상이 알케닐 라디칼을 함유하는, 옥심 그룹 함유 유기 라디칼에 의해 말단 차단된 디오가노폴리실록산(A), 실란 분자의 50% 이하가 알케닐을 함유하는 옥심 그룹 함유 오가노실란(B) 및 무기 충전제(C)를 포함한다.

명세서

[발명의 명칭]

원 패키지 실은 경화성 실리콘 엘라스토머 조성물

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

분자 쇠의 양쪽 말단에 일반식(I)의 라디칼을 갖는 디오가노폴리실록산 분자 30중량% 이상과 분자 쇠의 한쪽 말단에 일반식(I)의 라디칼을 갖고 분자 쇠의 다른 쪽 말단에 일반식(II)의 라디칼을 갖는 디오가노폴리실록산 분자 70중량% 이하를 포함하며 25°C에서의 점도가 0.0005내지 0.3m²/s인 디오가노폴리실록산(A), 100중량부, 일반식(III)의 디오가노실란(B) 0.5 내지 20중량부 [성분(A) 100중량부를 기준으로 함] 및 무기 충전제(C) 0.5 내지 200중량부 [성분(A) 100중량부를 기준으로 함] 를 포함하는, 원 패키지 실은 경화성 실리콘 엘라스토머 조성물.



상기 식에서, R¹은 독립적으로 알킬 및 알케닐 라디칼로부터 선택되는 라디칼이며(단, 이의 50몰% 이상은 알케닐이다), R²은 각각 독립적으로 알킬 및 페닐로부터 선택되는 라디칼이며, X는 일반식 -N=CR²R³의 유기 라디칼(여기서, R² 및 R³은 각각 독립적으로 알킬, 페닐 및 알케닐 라디칼로 이루어진 그룹으로부터 선택되는 라디칼이다) 또는 일반식 $-N=\overset{\text{R}^4}{\underset{\text{C}}{\text{C}}}$ 의 유기 라디칼(여기서, R⁴는 탄소수 10 이하의 2가 탄화수소 라디칼이다)이고, R⁵는 독립적으로 알킬, 아릴 및 알케닐 라디칼로부터 선택되는 라디칼이다(단, 이의 50몰% 이하는 알케닐이다).

청구항 2

제1항에 있어서, 알케닐 라디칼이 비닐 라디칼인 원 패키지 실은 경화성 실리콘 엘라스토머 조성물.

청구항 3

제1항에 있어서, 무기 충전제가 초미립상 실리카인 원 패키지 실온 경화성 실리콘 엘라스토머 조성물.

청구항 4

제1항에 있어서, 성분(A) 100중량부를 기준으로 하여, 0.01 내지 5중량부의 주석 경화 촉매(D)를 추가로 포함하는 원 패키지 실온 경화성 실리콘 엘라스토머 조성물.

청구항 5

제1항에 있어서, 25℃에서의 점도가 0.001 내지 0.1^m/s의 범위인 원 패키지 실온 경화성 실리콘 엘라스토머 조성물.

청구항 6

제1항에 있어서, 성분(B)가 성분(A) 100중량부당 3 내지 15중량부의 양으로 존재하며, 비닐트리(메틸에틸 케톡시모)실란과 메틸트리(메틸 에틸 케톡시모)실란의 혼합물인 원 패키지 실온 경화성 실리콘 엘라스토머 조성물.

청구항 7

제3항에 있어서, 실리카(C)가 성분(A) 100중량부당 3 내지 20중량부의 양으로 존재하는 원 패키지 실온 경화성 실리콘 엘라스토머 조성물.

청구항 8

제1항에 있어서, 접착 촉진제를 추가로 포함하는 원 패키지 실온 경화성 실리콘 엘라스토머 조성물.

청구항 9

제5항에 있어서, 디오가노폴리실록산(A)가 디메틸폴리실록산인 원 패키지 실온 경화성 실리콘 엘라스토머 조성물.

청구항 10

제9항에 있어서, 성분(A)가, 분자 쇠 말단의 5몰% 이상이 R₃RSi⁶-인 디메틸폴리실록산의 혼합물인 원 패키지 실온 경화성 실리콘 엘라스토머 조성물.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.